

3D-Micromac präsentiert die TLS-Dicing™-Technologie zur Semicon West 2017

Das Chemnitzer Unternehmen stellt das microDICE™-Laser-Mikrobearbeitungssystem und weitere innovative Prozesslösungen für die Halbleiterindustrie auf der Semicon West 2017 in San Francisco vor

Die 3D-Micromac AG, der führende Spezialist für Lasermikrobearbeitung, präsentiert hocheffiziente Lasermikrobearbeitungssysteme zur Bearbeitung von Halbleitermaterialien auf der Semicon West vom 11. bis 13. Juli 2017 in San Francisco, USA. Im Fokus des diesjährigen Messeauftritts steht die TLS-Dicing™-Technologie zum schnellen und kosteneffizienten Separieren von Halbleiterwafern in Chips, welche in die microDICE™ Fertigungssysteme integriert ist.



microDICE™ Laserbearbeitungssystem

TLS-Dicing™ ist ein kontakt- und rückstandsfreies Verfahren basierend auf thermisch induzierter mechanischer Spannung zur Trennung spröder Halbleitermaterialien wie Silizium, Siliziumkarbid (SiC), Germanium (Ge) und Galliumarsenid (GaAs). Im Vergleich zu herkömmlichen Vereinzelungstechnologien erzielt die TLS-Dicing™ einen bis zu 30-fach höheren Durchsatz beim Trennen von Siliziumkarbid-Wafern. Dabei sind die Invest- und Betriebskosten entsprechend niedrig, so dass Kosteneinsparungen in Größenordnungen erzielt werden können.

Über die 3D-Micromac AG

Die 3D-Micromac AG ist der führende Spezialist für Lasermikrobearbeitung. Wir entwickeln Verfahren, Maschinen und komplette Anlagen auf höchstem technischen und technologischen Niveau. Unser Anspruch ist es, die Wünsche unserer Kunden auch bei komplexen Projekten perfekt zu erfüllen.

3D-Micromac steht für leistungsfähige, anwenderfreundliche und zukunftsorientierte Prozesse mit größter Produktionseffizienz. Durch unsere Technologien werden Innovationen verfügbar – und das weltweit.

Weitere Informationen: <http://www.3d-micromac.com>

Pressekontakt:

3D-Micromac AG
Mandy Gebhardt
Leiterin Marketing und Öffentlichkeitsarbeit

Tel: +49 (0)371 400 43-26

E-Mail: gebhardt@3d-micromac.com